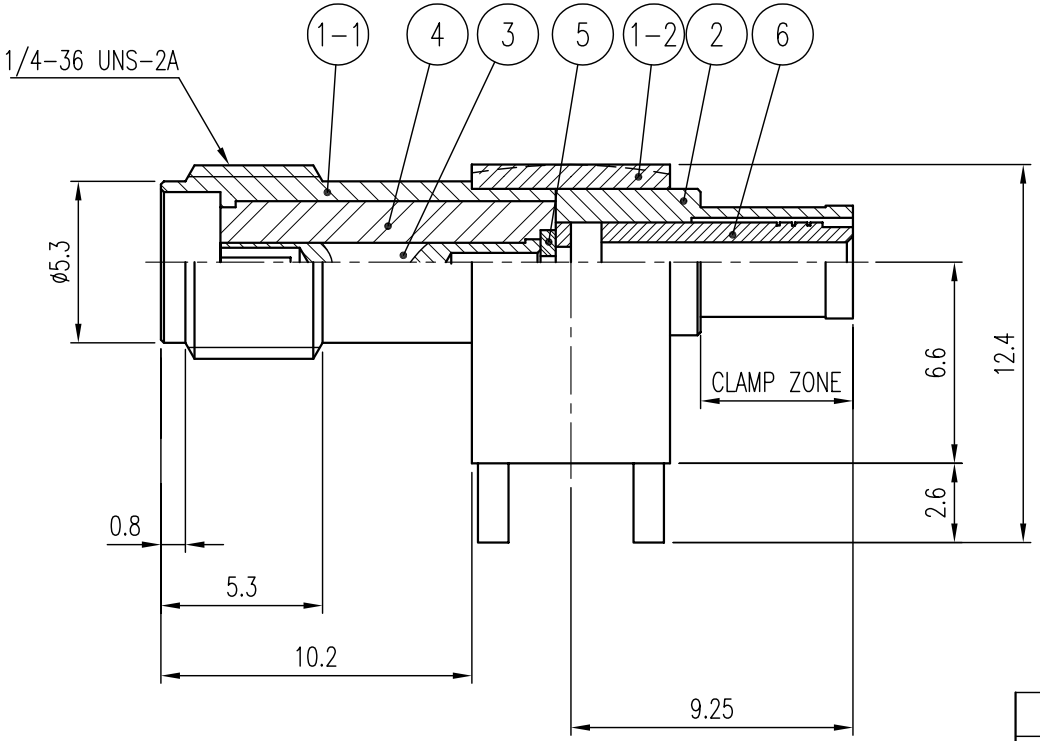
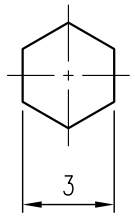
기공 / ST										
ST(기존)										
ST(개선)										

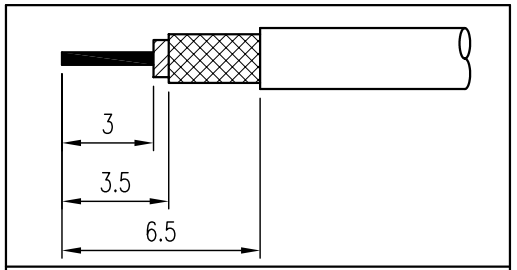
수 정 내 용

부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
1	신뢰성 향상(설변No.연구2006-237) (CONN삽촉불량-BODY 구조 변경)	김은희	윤상진	2006. 12. 11.
2	(설변처리No.201102-0002) 억지끼움시 burr 개선 치수 변경	김인철	최영호	2011. 02. 11.

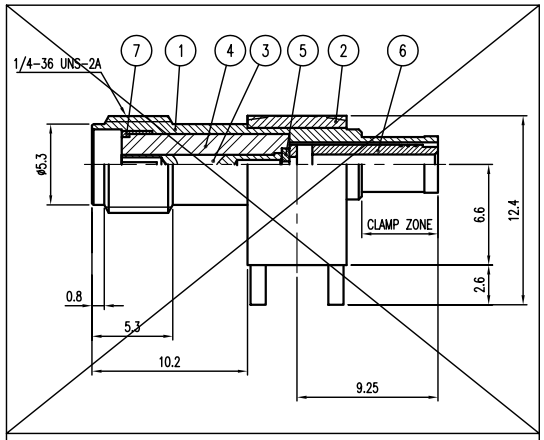




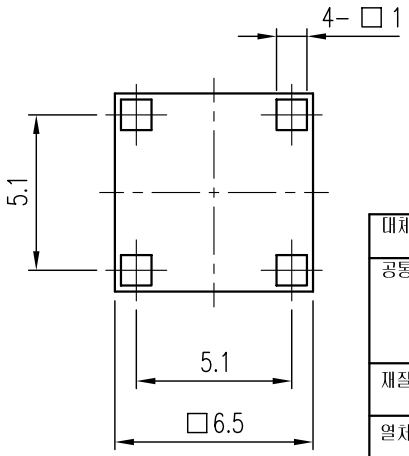
Crimping Tool Size



CABLE 탈피도



설변 전 (VER.0)



6		INSERT	1	MBsBD	Gold Plate	DIS00116-5/1
5		INSULATOR	1	TEFLON		DIN01148-N/1
4		INSULATOR	1	TEFLON		DIN01224-N/1
3		CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT01442-5/1
2		BODY (C)	1	MBsBD	Gold Plate	DBD01775-5/2 ~~DBD01775-5/1~~
1	1-2	BODY (B)	1	MBsBD	Gold Plate	DBB00124-5/1 DBD01863-3/1
	1-1	BODY (A)	1	MBsBD	Gold Plate	DBB00124-5/1 DBD01862-3/1
품번		품 명	수량	재 질	표면처리	비 고

대체가능재질			
공통공차	소수 각도 분수		
재질			
열처리			
보호피막처리			
년월일	2011. 2. 11.		
승인	Y. H. CHOI		
검도			
제도	I. C. KIM		
작성부서	연 구 소		
척도	4/1	단위 mm	중량 —

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 SMA-J-4R-#59(MCBG)

A4

도번 CN01530-7/3

K314-634-004